

<<电子产品制作工艺与实训>>

图书基本信息

书名：<<电子产品制作工艺与实训>>

13位ISBN编号：9787121101137

10位ISBN编号：7121101130

出版时间：2012-6

出版时间：电子工业出版社

作者：廖芳 编

页数：332

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品制作工艺与实训>>

前言

随着科学技术的发展和电子技术的进步,电子产品已渗透到各个领域,从家用电器、办公自动化设备、教学仪器到高科技产品,处处可见电子产品的应用。

因而电子产品的品质和制作工艺已成为人们极其关心的问题,电子产品的制作人员也成为市场急需的专业人才。

《电子产品制作工艺与实训》教材贯彻了高职高专培养目标,强调了理论与实践的结合,把握了教材与实际的结合,突出了操作与管理的结合。

本教材采纳了当前电子行业先进的电子产品制作工艺与管理手段等技术,并结合电子制造业、电路设计与制板、现代电子设备的管理与维修等就业岗位群的实际需要以及学生的专业基本素养要求,同时考虑电子类职业技能鉴定和各种层次的电子竞赛等方面的要求来编写。

教材内容包括了电子产品制作的完整的工艺过程和配套的实训项目。

本教材内容丰富、贴近现实、简洁适用,可大大缩短人才培养与电子企业需求的距离。

教材特点:《电子产品制作工艺与实训》是《电子产品生产工艺与管理》升级版教材,本教材具有以下特点: 1. 本教材顺应高职高专教学改革的需要,以“项目导向、任务驱动、教-学-做三位一体”的教学理念来构建教材格式。

以电子整机产品制作工艺作为“项目导向”,以电子产品的设计、装配、调试、测试、维护、管理主要岗位工作任务为驱动,分解教学任务,确定教学单元,进行化整为零、由浅入深的教材结构的设计。

2. 本教材由专业教师和电子行业、企业技术人员及专家共同合作完成。

有关电子行业的技术人员及专家提供了教材中一些相关资料,并提出了指导性意见;专业教师执笔完成教材的编写。

教材内容充分体现了目前电子行业的新技术、新工艺、新的管理知识和理念,教材的内容来源于实践又高于实践。

3. 本教材强调实践技能的培养。

教材精选了20个相关的电子实训项目供学生和其他读者进行实操操作。

实训的内容结合了电子产品制作的实际工作过程、电子大赛的要求和案例以及职业技能考核的相关知识,选择的一些典型、适用的单元电路或整机电路。

从基础的基础训练到综合性的课题实训,循序渐进的安排,能及时、有效地将理论知识转化为实际操作技能,强化学生动手能力的培养。

4. 本教材注重多门课程知识的综合。

相关课程(如电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、电子测量、protel等)的知识在该课程上得以有机综合并转化为实际应用,有助于提高学生的专业综合素质。

5. 本教材配备了相应的电子课件,可供教师在教学中使用,也可供学生复习或自学。

教学安排建议:由于《电子产品制作工艺与实训》是一本实践性很强的技能性教材,在教学安排上作如下建议: 1. 课时分配。

理论课时实践课时=1 2? 2. 实训项目的选用。

20个电子实训项目中,基础训练必选,课题实训项目各院校可根据本校的实际情况自行选择。

3. 教学方式。

理论教学采用电子课件与板书结合的方式进行;实践教学采用课堂实训、集中实训、第二课堂的形式进行。

<<电子产品制作工艺与实训>>

内容概要

《电子产品制作工艺与实训》教材以培养电子行业的高级技能型人才为宗旨，注重理论与实际相结合，生产技能和管理方法相结合，讲授了电子产品制作工艺和生产管理等方面的知识，并配备有20个实训项目，使读者能够更好地掌握该教材的知识并及时转化为实际技能。

本教材的主要内容包括：常用电子元器件及其检测、电子产品装配中的常用工具、专用设备和基本材料、装配前的准备工艺、手工焊接技术、焊接工艺、印制电路板的设计与制作、电子产品的整机设计和装配工艺、调试工艺、整机检验、防护及产品包装、电子产品生产管理、电子实训等。每章前有内容提要，每章后有小结、习题，书末还有每章习题的参考答案。

本教材是国家级“十一五”规划教材。

教材配备有配套的电子课件，可供教师在教学中使用，也可供学生复习或自学。

本教材可以作为高职高专院校电子信息类专业的技能性教材，也可用作电子大赛的基础培训教材，或供电子行业的工程技术人员参考。

<<电子产品制作工艺与实训>>

书籍目录

第1章 常用电子元器件及其检测 1.1 电阻 1.1.1 电阻的基本知识 1.1.2 固定电阻的主要性能参数
 1.1.3 固定电阻的标注方法 1.1.4 敏感电阻的性能与用途 1.1.5 微调电阻和电位器的主要性能
 指标 1.1.6 电阻的检测方法 1.2 电容 1.2.1 电容的基本知识 1.2.2 电容的主要性能参数
 1.2.3 电容的标注方法 1.2.4 电容的检测方法 1.3 电感和变压器 1.3.1 电感和变压器的基本知
 识 1.3.2 电感及变压器的主要性能参数和标注方法 1.3.3 电感与变压器的检测方法 1.4 半导体
 分立器件 1.4.1 半导体分立器件的型号命名 1.4.2 二极管 1.4.3 桥堆 1.4.4 晶体三极管(双
 极性三极管) 1.4.5 晶闸管 1.4.6 场效应管(FET) 1.5 集成电路 1.5.1 集成电路的分类及命
 名方法 1.5.2 集成电路的引脚识别与使用注意事项 1.5.3 常用集成电路芯片介绍 1.5.4 集成电
 路的检测方法 1.6 开关件、接插件及熔断器 1.6.1 开关件的作用、分类及主要参数 1.6.2 开关
 件的检测 1.6.3 继电器及其检测 1.6.4 接插件及其检测 1.6.5 熔断器及其检测 1.7 电声器件
 1.7.1 扬声器 1.7.2 耳机 1.7.3 传声器 1.8 表面安装元器件 1.8.1 表面安装元器件的特点
 、分类及应用场合 1.8.2 表面安装元器件的规格 1.8.3 使用表面安装元器件的注意事项 本章小
 结 习题1第2章 电子产品装配中的常用工具、专用设备和基本材料 2.1 常用工具 2.1.1 普通工
 具 2.1.2 专用工具 2.2 常用的专用设备 2.3 基本材料 2.3.1 电子产品中的绝缘材料 2.3.2 电
 子产品中的常用线料 2.3.3 塑料 2.3.4 漆料 2.3.5 粘合剂 本章小结 习题2第3章 装配前的准
 备工艺 3.1 识图 3.1.1 识图的基本知识 3.1.2 常用图纸的功能及读图方法 3.2 导线的加工
 3.2.1 普通导线的加工 3.2.2 屏蔽导线或同轴电缆的加工 3.2.3 扁平电缆的加工 3.2.4 线把的
 扎制 3.3 元器件引线的成形加工 3.3.1 元器件引线成形的技术要求 3.3.2 元器件引线成形的方
 法 本章小结 习题3第4章 手工焊接技术 4.1 焊接的基本知识 4.1.1 焊接的概念和种类 4.1.2
 锡焊的基本过程 4.1.3 锡焊的基本条件第5章 焊接工艺第6章 印制电路板的设计与制作第7章
 电子产品的整机设计和装配工艺第8章 调试工艺第9章 整机检验、防护及产品包装第10章 电子产品生
 产管理第11章 电子实训参考文献

<<电子产品制作工艺与实训>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>